

2011-2015年中国LED封装行业市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国LED封装行业市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/yingjian1107/Q775043IVO.html>

【报告价格】 纸介版**6500**元 电子版**6800**元 纸介+电子**7000**元

【出版日期】 2011-07-14

【交付方式】 Email电子版/特快专递

【订购电话】 全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国LED封装行业市场分析与投资前景研究报告》系统全面的调研了LED封装产业的市场宏观环境情况、行业发展情况、市场供需情况、企业竞争力情况、产品品牌价值情况等，以产品微观部分作为调研重点，采用纵向分析和横向对比相结合的方法，分别对LED封装产业产品的国内外生产消费情况、原材料市场情况、产品技术情况、产品市场竞争情况、重点企业发展情况、产品品牌价值以及产品营销策略等方面进行深入的调研分析。

LED封装是一个涉及到多学科（如光学、热学、机械、电学、力学、材料、半导体等）的研究课题。从某种角度而言，LED封装不仅是一门制造技术（Technology），而且也是一门基础科学（Science），良好的封装需要对热学、光学、材料和工艺力学等物理本质的理解和应用。LED封装设计应与芯片设计同时进行，并且需要对光、热、电、结构等性能统一考虑。在封装过程中，虽然材料（散热基板、荧光粉、灌封胶）选择很重要，但封装结构（如热学界面、光学界面）对LED光效和可靠性影响也很大，大功率白光LED封装必须采用新材料，新工艺，新思路。对于LED灯具而言，更是需要将光源、散热、供电和灯具等集成考虑。目前中国LED封装技术与国外的差距主要在研发投入的差距。随着中国国力的增长，我们相信中国会成为LED封装强国。

第一章 LED封装相关概述

1.1 LED封装简介

1.1.1 LED封装作用

1.1.2 LED封装的形式

1.1.3 LED封装的结构类型

1.1.4 LED封装的工艺流程

1.1.5 LED封装对封装材料要求

1.2 LED封装的常见要素

1.2.1 LED引脚成形方法

1.2.2 LED弯脚及切脚

1.2.3 LED清洗

1.2.4 LED过流保护

1.2.5 LED焊接条件

第二章 2010-2011年中国LED封装产业整体运营态势分析

2.1 2010-2011年世界LED封装业的发展总况

2.1.1 世界LED封装业发展规模及应用

2.1.2 世界LED封装企业分析

2.1.3 世界LED封装技术先进性分析

2.2 2010-2011年中国LED封装业的发展综述

2.2.1 中国LED封装业发展成果

2.2.2 产值增长情况

2.2.3 产量增长情况

2.2.4 价格分析

2.2.5 利好因素

2.3 2010-2011年国内重要LED封装项目的建设进展

2.3.1 韩企投资扬州兴建LED封装基地

2.3.2 西安经开区LED封装线项目投产

2.3.3 长治高科LED封装项目竣工投产

2.3.4 敬亭园中园LED支架及封装项目开建

2.3.5 源力光电LED封装线正式投产

2.4 SMD LED封装

2.4.1 SMD LED封装市场发展简况

2.4.2 SMD LED封装技术壁垒较高

2.4.3 SMD LED封装产能尚未过剩

2.4.4 SMD LED封装受益于芯片价格下降

2.5 2010-2011年中国LED封装业发展中存在的热点问题探讨

2.5.1 制约我国LED封装业发展的因素

2.5.2 国内LED封装企业面临的挑战

2.5.3 封装业销售额与海外企业差距明显

2.5.4 传统封装工艺成为系统成本瓶颈

2.6 促进中国LED封装业发展的策略

2.6.1 做大做强LED封装产业的对策

2.6.2 发展LED封装行业的措施建议

2.6.3 LED封装业发展需加大研发投入

2.6.4 我国LED封装业应向高端转型

第三章 2010-2011年中国LED封装市场新格局透析

3.1 2010-2011年中国LED封装市场发展态势

3.1.1 中国成中低端LED封装重要基地

3.1.2 国内LED封装企业发展不平衡

3.1.3 中国LED封装市场缺乏大型企业

3.1.4 LED产业上游厂商涉足封装市场

3.1.5 台湾LED封装产能向大陆转移

3.2 中国LED封装企业分布状况

3.2.1 2009年LED封装企业区域分布

3.2.2 2010年LED封装企业区域分布

3.3 广东省LED封装业

3.3.1 主要特点

3.3.2 重点市场

3.3.3 发展趋势

第四章 2010-2011年中国LED封装行业技术研发进展状况

4.1 中外LED封装技术的差异

4.1.1 封装生产及测试设备差异

4.1.2 LED芯片差异

4.1.3 封装辅助材料差异

4.1.4 封装设计差异

4.1.5 封装工艺差异

4.1.6 LED器件性能差异

4.2 中国LED封装技术发展概况

4.2.1 封装技术影响LED产品可靠性

4.2.2 中国LED业专利集中在封装领域

4.2.3 中国LED封装业的技术特点

4.2.4 LED封装技术水平不断提升

4.2.5 LED封装业技术研发仍需加强

4.3 LED封装关键技术介绍

4.3.1 大功率LED封装的关键技术

4.3.2 显示屏用LED封装的技术要求

4.3.3 固态照明对LED封装的技术要求

第五章 2010-2011年中国LED封装设备及封装材料的发展

5.1 LED封装设备市场分析

5.1.1 我国LED封装设备市场概况

5.1.2 LED封装设备国产化亟需加速

5.1.3 发展我国LED封装设备业的思路

5.2 LED封装材料市场分析

5.2.1 LED封装主要原材介绍

5.2.2 我国LED封装材料市场简析

5.2.3 部分关键封装原材料仍依赖进口

5.2.4 LED封装用基板材料市场走向分析

5.3 LED封装支架市场

5.3.1 国内LED封装支架市场格局分析

5.3.2 LED封装支架技术未来发展趋势

5.3.3 我国LED封装支架市场前景广阔

第六章 2010-2011年中国LED封装产业竞争新形态分析

6.1 2010-2011年中国LED封装市场竞争格局

6.1.1 中国采购影响世界封装市场格局

6.1.2 我国LED封装市场各方力量简述

6.1.3 国内LED封装市场竞争加剧

6.1.4 本土LED封装企业整合步伐加速

6.2 2010-2011年中国LED封装企业竞争力简析

6.2.1 2009年本土封装企业竞争力排名

6.2.2 2010年本土LED封装企业竞争力排名

6.3 2011-2015年中国LED封装竞争趋势预测分析

第七章 2010-2011年全球LED封装顶尖企业分析

- 7.1 科锐 (CREE)
 - 7.1.1 企业概况
 - 7.1.2 企业LED封装运营态势
 - 7.1.3 企业发展战略分析
- 7.2 日亚化学 (NICHIA)
- 7.3 飞利浦 (Philips)
- 7.4 三星LED (Samsung LED)
- 7.5 首尔半导体 (SSC)

第八章 2010-2011年中国台湾主要LED封装重点企业运营分析

- 8.1 亿光电子
 - 8.1.1 企业概况
 - 8.1.2 企业LED封装运营态势
 - 8.1.3 企业发展战略分析
- 8.2 光宝集团
- 8.3 东贝光电
- 8.4 宏齐科技
- 8.5 台积电
- 8.6 艾笛森

第九章 2010-2011年中国内地主要LED封装重点企业

- 9.1 国星光电(002449)
 - 9.1.1 企业概况
 - 9.1.2 企业主要经济指标分析
 - 9.1.3 企业盈利能力分析
 - 9.1.4 企业偿债能力分析
 - 9.1.5 企业运营能力分析
 - 9.1.6 企业成长能力分析
- 9.2 雷曼光电
 - 9.1.1 企业概况
 - 9.1.2 企业LED封装运营态势
 - 9.1.3 企业发展战略分析

9.3 鸿利光电

9.1.1 企业概况

9.1.2 企业LED封装运营态势

9.1.3 企业发展战略分析

9.4 大族光电（002008）

9.4.1 企业概况

9.4.2 企业主要经济指标分析

9.4.3 企业盈利能力分析

9.4.4 企业偿债能力分析

9.4.5 企业运营能力分析

9.4.6 企业成长能力分析

9.5 深圳市瑞丰光电子有限公司

9.5.1 企业概况

9.5.2 企业主要经济指标分析

9.5.3 企业盈利能力分析

9.5.4 企业偿债能力分析

9.5.5 企业运营能力分析

9.5.6 企业成长能力分析

9.6 宁波升谱光电半导体有限公司

9.6.1 企业概况

9.6.2 企业主要经济指标分析

9.6.3 企业盈利能力分析

9.6.4 企业偿债能力分析

9.6.5 企业运营能力分析

9.6.6 企业成长能力分析

9.7 南京汉德森科技股份有限公司

9.7.1 企业概况

9.7.2 企业主要经济指标分析

9.7.3 企业盈利能力分析

9.7.4 企业偿债能力分析

9.7.5 企业运营能力分析

9.7.6 企业成长能力分析

第十章 2011-2015年中国LED封装产业发展趋势及前景

10.1 2011-2015年LED封装产业未来发展趋势

10.1.1 功率型白光LED封装技术发展趋势

10.1.2 LED封装技术将向模块化方向发展

10.1.3 LED封装产业未来发展走向分析

10.2 2011-2015年中国LED封装市场前景展望

10.2.1 我国LED封装市场发展前景乐观

10.2.2 LED封装产品应用市场将持续扩张

10.2.3 中国LED通用照明封装市场规模预测

第十一章 2011-2015年中国LED封装产业投资前景预测

11.1 2011-2015年中国LED封装行业投资概况

11.1.1 LED封装行业投资特性

11.1.2 LED封装具有良好的投资价值

11.1.3 LED封装投资环境利好

11.2 2011-2015年中国LED封装投资机会分析

11.2.1 LED封装投资热点（LED照明、LED照明电视）

11.2.2 国家节能减排衍生LED封装投资机会

11.3 2011-2015年中国LED封装投资风险及防范

11.3.1 技术风险分析

11.3.2 金融风险分析

11.3.3 政策风险分析

11.3.4 竞争风险

图表目录

图表：LED产品封装结构的类型

图表：2009年全球前十大封装厂商营业收入情况

图表：2009年全球前十大封装厂商市场占有情况

图表：全球主要LED封装企业的技术特色

图表：2009年世界LED封装产业的区域分布

图表：第三类企业的发展运作模式

图表：国际大部分著名LED宁波升谱光电半导体有限公司遵循的发展模式

图表：2003-2009年我国LED封装产业产值增长情况

图表：2003-2009年我国LED封装产量增长情况

图表：2009年台湾、大陆主要SMD LED宁波升谱光电半导体有限公司产能对比

图表：2010年中国大陆SMD LED主要厂商的扩产情况

图表：2010年在大陆扩产的主要港台企业

图表：国星光电LED芯片单价变动对LED封装产品毛利的影响

图表：2010年国内部分封装项目（台湾企业除外）

图表：2010-2011年台湾前8大LED封装厂SMD产能及大陆业务

图表：2010年台湾在大陆投资的LED封装项目

图表：2009年我国LE宁波升谱光电半导体有限公司在各领域的分布情况

图表：2009年我国LED封装企业区域分布情况

图表：2009年广东LED封装产量在全国的比例

图表：2009年广东LED封装产值在产业链中的比例

图表：广东部分LED封装企业的优势与特色

图表：部分广东省企业和研究机构的封装技术发明专利分布

图表：2009年广东LED封装企业区域分布情况

图表：广东LED器件封装应用领域

图表：2004-2009年我国LED封装行业产量及产值情况

图表：2009年我国LED封装企业竞争力排行榜

图表：2010年我国LED封装企业竞争力排行榜

图表：影响大功率LED封装技术的因素

图表：大功率LED的封装结构

图表：2010年中国LED各应用领域产值分布情况

图表：国星光电主要经济指标走势图

图表：国星光电经营收入走势图

图表：国星光电盈利指标走势图

图表：国星光电负债情况图

图表：国星光电负债指标走势图

图表：国星光电运营能力指标走势图

图表：国星光电成长能力指标走势图

图表：大族光电主要经济指标走势图

图表：大族光电经营收入走势图

图表：大族光电盈利指标走势图

图表：大族光电负债情况图

图表：大族光电负债指标走势图

图表：大族光电运营能力指标走势图

图表：大族光电成长能力指标走势图

图表：深圳市瑞丰光电子有限公司主要经济指标走势图

图表：深圳市瑞丰光电子有限公司经营收入走势图

图表：深圳市瑞丰光电子有限公司盈利指标走势图

图表：深圳市瑞丰光电子有限公司负债情况图

图表：深圳市瑞丰光电子有限公司负债指标走势图

图表：深圳市瑞丰光电子有限公司运营能力指标走势图

图表：深圳市瑞丰光电子有限公司成长能力指标走势图

图表：宁波升谱光电半导体有限公司主要经济指标走势图

图表：宁波升谱光电半导体有限公司经营收入走势图

图表：宁波升谱光电半导体有限公司盈利指标走势图

图表：宁波升谱光电半导体有限公司负债情况图

图表：宁波升谱光电半导体有限公司负债指标走势图

图表：宁波升谱光电半导体有限公司运营能力指标走势图

图表：宁波升谱光电半导体有限公司成长能力指标走势图

图表：南京汉德森科技股份有限公司主要经济指标走势图

图表：南京汉德森科技股份有限公司经营收入走势图

图表：南京汉德森科技股份有限公司盈利指标走势图

图表：南京汉德森科技股份有限公司负债情况图

图表：南京汉德森科技股份有限公司负债指标走势图

图表：南京汉德森科技股份有限公司运营能力指标走势图

图表：南京汉德森科技股份有限公司成长能力指标走势图

图表：中国LED通用照明封装市场规模增长情况及预测

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/yingjian1107/Q775043IVO.html>